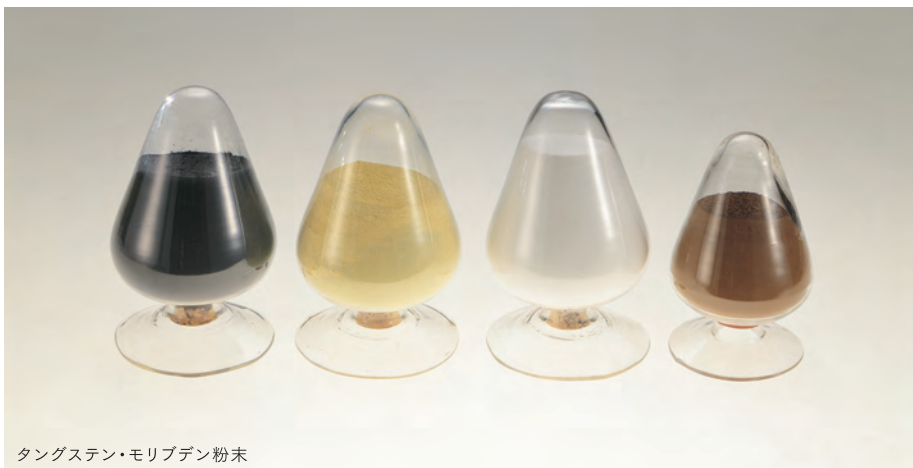


PRODUCTS

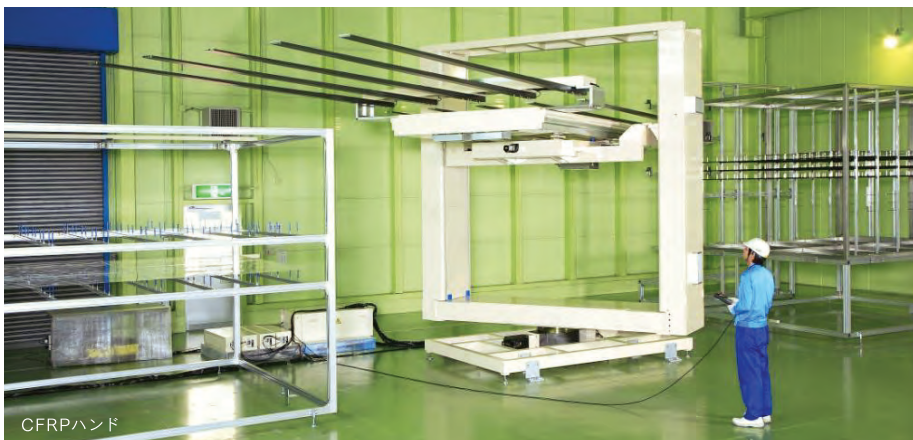
02

エレクトロニクス
関連素材/
炭素繊維製品

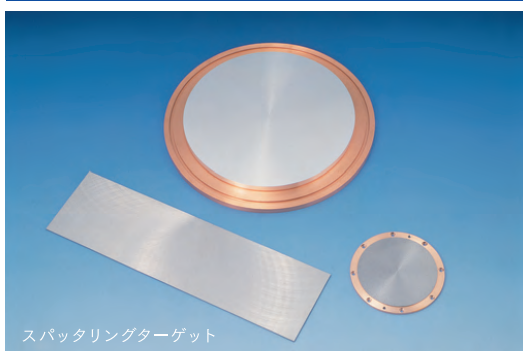
Electronics
Material/
Carbon Fiber
Products



タングステン・モリブデン粉末



CFRPハンド



スパッタリングターゲット

硬質・導電材料

タングステン・モリブデン・タンタル・ニオブ粉末、
炭化物・窒化物・ホウ化物・珪化物粉末、
その他各種金属粉末(日本新金属)、
タングステン・モリブデン製品(東邦金属)

Products for
powder
metallurgy,
electric
conductive
materials

Metallic powders—Tungsten, Molybdenum, Tantalum,
Niobium,
Advanced ceramic powders—Carbides, Nitrides,
Borides, Silicides,
Other various metallic powders (Japan New Metals),
Tungsten and molybdenum products (Toho Kinzoku)

電子金属材料

金ボンディングワイヤ、リードフレーム、
高純度ハンダ箔、電子材料用精密圧延品

Electron metallic
materials

Gold bonding wire, Lead frames, High-purity soldering foil,
Precision rolled products in the field of electronics

蒸着材料

Al・Ni・Au・Pd各種合金、
セラミック系スパッタリングターゲット

Vacuum evapora-
tion materials

Al, Ni, Au, Pd, other various metallic alloys,
Sputtering target of fine ceramics

高純度材料

ガリウム、インジウム、リン、錫

High purity
materials

Gallium, Indium, Phosphorus, Tin

炭素繊維製品

CF(カーボンファイバー)、プリプレグ、
CFRP(炭素繊維強化プラスチック)、
C/C(カーボン/カーボン)

Carbon fiber
products

CF (Carbon fiber), Prepreg,
CFRP (Carbon fiber reinforced plastics),
C/C (Carbon/Carbon)